

期刊	封面故事	趋势与分析			设计与技术	
		业界趋势	思维与观点	精英访谈	设计新技术	测试与测量
<b>1月刊</b> 广告预订截止日期: 2025年11月21日 材料提交截止日期: 2025年11月28日	新年展望——AI之上	·	·	·	智能家居 / 智能穿戴 / 智慧城市 工业物联网 / 边缘计算 无线通信 / 车联网 / 远程健康监控	信号完整性 频谱 / 协议分析仪 无线测试
<b>2月刊</b> 广告预订截止日期: 2025年12月22日 材料提交截止日期: 2025年12月30日	EDA, 从芯片到系统	·	·	·	PCB设计 模拟混合信号设计 FPGA/SoC设计	逻辑分析仪 时序分析 / 信号发生器 仿真软件
<b>3月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年1月20日 材料提交截止日期: 2026年1月28日	先进封装技术争夺战	·	·	·	Chiplet/3D堆栈 高密度互连 异构集成 / 混合键合	电气性能测试 热分析 / 失效分析 应力应变测量
<b>4月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年2月25日 材料提交截止日期: 2026年2月27日	存储芯片: 谁在定义AI时代的“第二增长曲线”?	·	·	·	高速缓存设计 内存墙挑战 / 存内计算 神经形态计算	数据完整性验证 功耗测量仪 逻辑分析仪
<b>5月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年3月20日 材料提交截止日期: 2026年3月30日	“镜”界新核, 点亮智能眼镜入口	·	·	·	AR/VR 显示技术 / 语音交互 / 人机界面 低功耗 / 小型化设计	光学性能测试 网络安全 / 电池安全 电池寿命测试
<b>6月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年4月20日 材料提交截止日期: 2026年4月30日	低空经济带来的半导体新机遇	·	·	·	IoT设备安全 密钥管理 / 防篡改设计 半导体信息安全 / 加密算法	侧信道分析仪 逻辑状态分析仪 EMI/EMC
<b>7月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年5月20日 材料提交截止日期: 2026年5月29日	800V高压平台, 倒逼汽车半导体革新	·	·	·	电池 / 充电桩 / 充电基础设施 新能源汽车 / 电动汽车 V2X/SDV/ADAS / 自动驾驶	电源完整性 安全测试 协议分析仪 / 网络分析仪
<b>8月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年6月19日 材料提交截止日期: 2026年6月30日	AI芯片, 从云到端	·	·	·	数据中心优化 / 绿色计算 分布式存储 网络安全	性能基准测试 / 能耗测量 自动化测试 网络延迟和带宽测试
<b>9月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年7月20日 材料提交截止日期: 2026年7月30日	RISC-V生态最新进展	·	·	·	处理器 / 硬件加速器 低功耗优化 嵌入式系统	处理器性能基准测试 硬件仿真器 功率分析仪
<b>10月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年8月20日 材料提交截止日期: 2026年8月28日	人形机器人热潮下的芯变革	·	·	·	视觉传感 / LiDAR IMU / 触觉传感 / 生物传感 定位与导航	分辨率分析仪 动态范围测试 传感器融合测试
<b>11月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年9月21日 材料提交截止日期: 2026年9月25日	宽禁带半导体应用“出圈”	·	·	·	高效电机驱动 新能源 / 智能电网 逆变器技术	电源完整性测试 高压大电流电源 / 热分析 高精度示波器
<b>12月刊</b> 广告预订截止日期: 2026年10月20日 材料提交截止日期: 2026年10月30日	国产GPU进化论	·	·	·	多核处理器 / 高性能计算 多媒体处理 AR/VR/AI加速	功耗分析仪 热成像仪 性能基准测试 / 兼容性测试

\* 仅限中国大陆版

## 编辑查询

有关中国大陆版的编辑及其他相关事项查询, 请与 Luffy.Liu (Luffy.Liu@aspencore.com) 联系。

注: 发行人保留对以上文章删除及改动的权利。